

JORNADA TÉCNICA:

Pulido/bombardeo iónico

16.05.2019



Pulido/bombardeo iónico

FECHA: 16/05/2019

PRECIO: GRATUITO PERO OBLIGATORIO, EL WORKSHOP ESTÁ LIMITADO A 25 PARTICIPANTES

LUGAR: CIDETEC SURFACE ENGINEERING: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Pº MIRAMÓN, 191 20014 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, SPAIN

¿CÓMO LLEGAR?

Este Workshop tiene como objetivo acercar a la industria las ventajas y buenas prácticas del pulido iónico para SEM y TEM. Está invitado a unirse a nosotros ese día. Tendrá la oportunidad de traer consigo sus propias muestras y discutir con nuestros especialistas el mejor método y condiciones de preparación de las mismas con esta técnica. Venga y descubra como el Leica EM TXP y Leica EM TIC3X pueden ayudarle a:

- Realizar secciones transversales de gran calidad
- Realizar pulidos superficiales en plano de casi cualquier material
- Minimizar la deformación o daño durante la preparación

LEICA EM TXP / TIC 3X WORKSHOP – THURSDAY 16TH MAY 2019

AGENDA

8.30–9.00	Welcome participants at CIDETEC	
9.00–9.15	Introduction of the day	Santiago Sevillano, Leica Microsystems
9.15–09.30	Welcome at CIDETEC	Gemma Vara, Head of Marketing and Positioning Patricia López, CIDETEC Surface engineering
09.30–11.00	Introduction to Ion Beam Milling	Santiago Sevillano, Leica Microsystems
11.00–11.30	Coffee break	
11.30–13.30	Open discussion of your samples	Santiago Sevillano, Leica Microsystems
13.30–14.30	Lunch break	
14.30–16.30	Hands-on on the equipment Leica EM TXP & EM TIC 3X	
16.30–17.00	Coffee break	
17.00–18.30	Hands-on on the equipment EM TXP & EM TIC 3X (continued)	
18.30	Round table and closing remarks	

Inscríbete Puede contactar con Santiago Sevillano si desea más información o para inscribirse: santiago.sevillano@leica-microsystems.com